

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零二零年第四季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2021年2月9日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二零年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零二零年第四季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入再創歷史新高，達 2.801 億美元，同比上升 15.4%，環比上升 10.7%。
- 毛利率 25.8%，同比下降 1.4 個百分點，環比上升 1.6 個百分點。
- 期內溢利 2,820 萬美元，上年同期為 1,400 萬美元，上期為 110 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 4,360 萬美元，上年同期為 2,620 萬美元，上季度為 1,770 萬美元。
- 基本每股盈利 0.034 美元，上年同期為 0.020 美元，上季度為 0.014 美元。
- 淨資產收益率（年化）7.2%，同比上升 2.4 個百分點，環比上升 4.0 個百分點。

二零二一年第一季度指引

- 我們預計銷售收入約 2.88 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 23%至 25%之間。

二零二零年度股利派發

- 公司將會在二零二一年五月召開的周年大會上，決定二零二零會計年度股利分配方案。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對第四季度及二零二零年全年業績評論道：

“我們對第四季度的業績非常滿意。在 MCU、IGBT、超級結、SGT 以及 CIS 等產品的強烈需求推動下，第四季度銷售收入遠超指引，達到了歷史新高的 2.801 億美元，較去年同期增長 15.4%，較上季度增長 10.7%。受益於消費及通訊市場回暖、產品結構的持續優化，毛利率也超過指引，為 25.8%。尤為值得一提的是，無錫 12 吋生產線第四季度銷售收入較上季度增加了一倍以上，對此我們深感自豪。”

“二零二零年毋庸置疑是不尋常的一年。面對突如其來的新冠疫情和充滿挑戰的半導體產業環境，全體同仁協力同心，在精準防控常態化的前提下保證了生產運營的穩定和高效。8 吋生產線在產能利用率滿載的情況下持續提升營運效率；12 吋生產線的機台搬入進度、技術研發進度、客戶拓展進度均大幅領先於原計劃。IGBT、MCU、CIS 等產品需求極為強勁，引領了公司銷售收入不斷創出歷史新高。從第二季度到第四季度，連續三個季度實現了環比雙位數增長。NOR、BCD、超級結和 IGBT 等在 12 吋生產線上的研發均已通過可靠性驗證，為公司的中長期發展再添新動能。能取得這樣卓越的成績，應該完全歸功於全體員工的不懈努力，以及所有客戶和廠商的鼎力支持。”

唐先生總結道：“二零二零年全年銷售收入達 9.613 億美元，創下歷史新高。展望二零二一年，我們將繼續在快速擴產的同時拓展技術平臺，例如工業 MCU、新一代超級結等。機會屬於有準備的人。我們非常有信心引領公司達到一個新的高度！”

電話會議公告

日期： 二零二一年二月十日（星期三）

時間： 上午 08:30（上海 / 香港）
下午 07:30（紐約，2021 年 2 月 9 日，星期二）

發言人： 唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php 或

<https://edge.media-server.com/mmc/p/njk6h7kg>

（注：需要注冊才能訪問網絡直播）

電話詳細：	中國大陸	+86 400 820 9615 或 +86 800 820 7535
	中國香港	+852 3018 6768
	中國臺灣	+886 2 7703 1751
	新加坡	+65 6713 5521
	美國	+1 347 549 4095

電話會議登入名： 5695533

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重複收聽會議。

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等特色工藝平臺，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業，擁有 8+12 英寸生產線先進工藝技術的企業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約 18 萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內建設一座月產能 4 萬片的 12 英寸晶圓廠（華虹七廠），“IC + Discrete”強大的工藝技術平臺有力支持物聯網等新興領域應用。不僅是中國大陸領先的 12 吋特色工藝生產線，亦為全球第一條 12 吋功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二零年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零二零年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	280,094	242,784	252,981	15.4 %	10.7 %
銷售成本	(207,825)	(176,755)	(191,689)	17.6 %	8.4 %
毛利	72,269	66,029	61,292	9.5 %	17.9 %
毛利率	25.8%	27.2 %	24.2 %	(1.4)	1.6
經營開支	(61,134)	(71,361)	(74,200)	(14.3)%	(17.6)%
其他收入淨額	24,493	24,145	24,056	1.4 %	1.8 %
稅前溢利	35,628	18,813	11,148	89.4 %	219.6 %
所得稅開支	(7,421)	(4,785)	(10,046)	55.1 %	(26.1)%
期內溢利	28,207	14,028	1,102	101.1 %	2,459.6 %
淨利潤率	10.1 %	5.8 %	0.4 %	4.3	9.7
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	43,609	26,186	17,694	66.5 %	146.5 %
非控股權益	(15,402)	(12,158)	(16,592)	26.7 %	(7.2)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.034	0.020	0.014	70.0 %	142.9 %
攤薄	0.033	0.020	0.013	65.0 %	153.8 %
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	628	515	577	21.9 %	8.8 %
產能利用率 ¹	99.0 %	88.0 %	95.8 %	11.0	3.2
淨資產收益率 ²	7.2 %	4.8 %	3.2 %	2.4	4.0

二零二零年第四季度

- 銷售收入再創歷史新高，達 2.801 億美元，同比上升 15.4%，環比上升 10.7%，主要得益於 CIS、MCU 及 IGBT 產品的需求上升。
- 銷售成本 2.078 億美元，同比上升 17.6%，環比上升 8.4%，主要由於晶圓銷售量上升所致。
- 毛利率 25.8%，同比下降 1.4 個百分點，主要由於平均銷售價格下降，部分被產能利用率提升所抵消；環比上升 1.6 個百分點，主要由於產能利用率提升。
- 經營開支 6,110 萬美元，同比下降 14.3%，環比下降 17.6%，主要由於研發活動的政府補助增加，部分被折舊費用增加所抵消。
- 其他收入淨額 2,450 萬美元，同比上升 1.4%，環比上升 1.8%，主要得益於匯兌收益和分佔一家聯營公司溢利增加，部分被政府補貼減少所抵消。
- 所得稅開支 740 萬美元，同比上升 55.1%，主要由於應課稅利潤增加。
- 期內溢利 2,820 萬美元，上年同期為 1,400 萬美元，上季度為 110 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 4,360 萬美元，上年同期為 2,620 萬美元，上季度為 1,770 萬美元。
- 基本每股盈利 0.034 美元，上年同期為 0.020 美元，上季度為 0.014 美元。
- 淨資產收益率（年化）7.2%，同比上升 2.4 個百分點，環比上升 4.0 個百分點。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

分部經營業績
(以千美元計，營運數據除外)

	二零二零年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零二零年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
華虹 8 吋					
銷售收入	244,390	235,370	236,378	3.8 %	3.4 %
毛利	69,963	66,427	64,278	5.3 %	8.8 %
毛利率	28.6 %	28.2 %	27.2 %	0.4	1.4
經營開支	(15,983)	(37,997)	(30,791)	(57.9)%	(48.1)%
稅前溢利	67,061	43,625	45,009	53.7 %	49.0 %
息稅折舊及攤銷前利潤	98,193	76,446	80,035	28.4 %	22.7 %
息稅折舊及攤銷前利潤率	40.2 %	32.5 %	33.9 %	7.7	6.3
付運晶圓(8 吋仔片)	544	506	537	7.5 %	1.3 %
華虹無錫					
銷售收入	35,704	7,414	16,603	381.6 %	115.0 %
毛利	2,306	(398)	(2,986)	(679.4)%	(177.2)%
毛利率	6.5 %	(5.4)%	(18.0)%	11.9	24.5
經營開支	(45,151)	(33,364)	(43,409)	35.3 %	4.0 %
稅前溢利	(31,433)	(24,812)	(33,861)	26.7 %	(7.2)%
息稅折舊及攤銷前利潤	(4,426)	(17,555)	(11,517)	(74.8)%	(61.6)%
息稅折舊及攤銷前利潤率	(12.4)%	(236.8)%	(69.4)%	224.4	57.0
付運晶圓(折合 8 吋仔片)	84	9	40	833.3 %	110.0 %

華虹 8 吋

- 銷售收入 2.444 億美元，同比上升 3.8%，環比上升 3.4%，主要得益於 MCU、LED 照明及電源管理產品的需求增加。
- 毛利率 28.6%，同比上升 0.4 個百分點，環比上升 1.4 個百分點，主要由於產能利用率提升。
- 經營開支 1,600 萬美元，同比下降 57.9%，環比下降 48.1%，主要由於研發活動的政府補助增加。
- 稅前溢利 6,710 萬美元，同比上升 53.7%，環比上升 49.0%。

華虹無錫

- 銷售收入 3,570 萬美元，上年同期為 740 萬美元，上季度為 1,660 萬美元。
- 經營開支 4,520 萬美元，同比上升 35.3%，環比上升 4.0%，主要由於折舊費用增加。
- 息稅折舊及攤銷前虧損 440 萬美元，較上季度減少 710 萬美元。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (已審核)	同比
銷售收入	961,279	932,567	3.1 %
銷售成本	(726,486)	(650,107)	11.7 %
毛利	234,793	282,460	(16.9)%
毛利率	24.4 %	30.3 %	(5.9)
經營開支	(269,308)	(178,624)	50.8 %
其他收入淨額	80,592	77,737	3.7 %
稅前溢利	46,077	181,573	(74.6)%
所得稅開支	(12,762)	(26,588)	(52.0)%
年內溢利	33,315	154,985	(78.5)%
淨利潤率	3.5 %	16.6 %	(13.1)
以下各方應佔利潤：			
母公司擁有人	99,443	162,237	(38.7)%
非控股權益	(66,128)	(7,252)	811.9 %
持有人應佔每股盈利			
基本	0.077	0.126	(38.9)%
攤薄	0.076	0.125	(39.2)%
付運晶圓(折合 8 吋任片)	2,191	1,974	11.0 %
產能利用率	92.7 %	91.2 %	1.5
淨資產收益率	4.2 %	7.4 %	(3.2)

二零二零年度

- 銷售收入創歷史新高，達 9.613 億美元，較上年度增長 3.1%。
- 銷售成本 7.265 億美元，較上年度上升 11.7%，主要由於晶圓銷售量及折舊費用的上升所致。
- 毛利率 24.4%，較上年度下降 5.9 個百分點，主要由於晶圓平均售價下降，人員開支及折舊費用的上升所致。
- 經營開支 2.693 億美元，較上年度上升 50.8%，主要由於研發成本、人員開支及折舊費用的上升所致。
- 其他收入淨額 8,060 萬美元，比上年度上升 3.7%，主要由於(i)本年實現匯兌收益而上年為匯兌損失，(ii)分佔一家聯營公司溢利增加，部分被以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益及利息收入減少所抵消。
- 年內溢利 3,330 萬美元，上年度為 1.550 億美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 9,940 萬美元，上年度為 1.622 億美元。
- 基本每股盈利 0.077 美元，上年度為 0.126 美元。
- 淨資產收益率 4.2%。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)	同比
華虹 8 吋			
銷售收入	897,202	925,153	(3.0)%
毛利	236,272	282,859	(16.5)%
毛利率	26.3 %	30.6 %	(4.3)
經營開支	(102,214)	(119,707)	(14.6)%
稅前溢利	181,031	197,027	(8.1)%
息稅折舊及攤銷前利潤	312,635	319,724	(2.2)%
息稅折舊及攤銷前利潤率	34.8 %	34.6 %	0.2
付運晶圓(8 吋仔片)	2,042	1,965	3.9 %
華虹無錫			
銷售收入	64,077	7,414	764.3 %
毛利	(1,479)	(398)	271.6 %
毛利率	(2.3)%	(5.4)%	3.1
經營開支	(167,094)	(58,917)	183.6 %
稅前溢利	(134,954)	(15,455)	773.2 %
息稅折舊及攤銷前利潤	(57,236)	(8,198)	598.2 %
息稅折舊及攤銷前利潤率	(89.3)%	(110.6)%	21.3
付運晶圓(折合 8 吋仔片)	149	9	1,555.6 %

華虹 8 吋

- 銷售收入 8.972 億美元，較上年度下降 3.0%，主要由於平均銷售價格下降，部分被銷售數量增加所抵消。
- 毛利率 26.3%，較上年度下降 4.3 個百分點，主要由於平均銷售價格下降，部分被產能利用率提升所抵消。
- 經營開支 1.022 億美元，較上年度下降 14.6%，主要由於研發活動的政府補助增加，部分被折舊費用增加所抵消。
- 稅前溢利 1.810 億美元，較上年度下降 8.1%。

華虹無錫

- 銷售收入 6,410 萬美元，上年度為 740 萬美元。
- 經營開支 1.671 億美元，上年度為 5,890 萬美元，主要由於研發開支、折舊及人工費用增加。
- 息稅折舊及攤銷前虧損 5,720 萬美元。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二零年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第四季度 % (未經審核)	二零一九年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	270,197	96.5 %	233,385	96.1 %	36,812	15.8 %
其他	9,897	3.5 %	9,399	3.9 %	498	5.3 %
銷售收入總額	280,094	100.0 %	242,784	100.0 %	37,310	15.4 %

- 本季度 96.5% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二零年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第四季度 % (未經審核)	二零一九年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	244,390	87.3 %	235,370	96.9 %	9,020	3.8 %
12 吋晶圓	35,704	12.7 %	7,414	3.1 %	28,290	381.6 %
銷售收入總額	280,094	100.0 %	242,784	100.0 %	37,310	15.4 %

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.444 億美元及 3,570 萬美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二零年	二零二零年	二零一九年	二零一九年	同比	同比
	第四季度	第四季度	第四季度	第四季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
中國 ³	197,056	70.4 %	153,476	63.2 %	43,580	28.4 %
亞洲 ⁴	33,573	12.0 %	32,549	13.4 %	1,024	3.1 %
美國	28,377	10.1 %	31,928	13.2 %	(3,551)	(11.1)%
歐洲	14,407	5.1 %	16,820	6.9 %	(2,413)	(14.3)%
日本 ⁵	6,681	2.4 %	8,011	3.3 %	(1,330)	(16.6)%
銷售收入總額	280,094	100.0 %	242,784	100.0 %	37,310	15.4 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 1.971 億美元，占銷售收入總額的 70.4%，同比增長 28.4%，主要得益於 CIS、IGBT、通用 MOSFET 及 LED 照明產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 3,360 萬美元，同比增長 3.1%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於美國的銷售收入 2,840 萬美元，同比減少 11.1%，主要由於邏輯及通用 MOSFET 產品的需求減少。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,440 萬美元，同比減少 14.3%，主要由於通用 MOSFET 產品的需求減少。
- 本季度來自於日本的銷售收入 670 萬美元，同比減少 16.6%，主要由於邏輯產品的需求減少。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零二零年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第四季度 % (未經審核)	二零一九年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	97,041	34.7 %	98,028	40.3 %	(987)	(1.0)%
分立器件	94,229	33.6 %	87,879	36.2 %	6,350	7.2 %
邏輯及射頻	45,894	16.4 %	23,046	9.5 %	22,848	99.1 %
模擬與電源管理	39,509	14.1 %	30,327	12.5 %	9,182	30.3 %
獨立非易失性存儲器	2,912	1.0 %	3,322	1.4 %	(410)	(12.3)%
其他	509	0.2 %	182	0.1 %	327	179.7 %
銷售收入總額	280,094	100.0 %	242,784	100.0 %	37,310	15.4 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 9,700 萬美元，同比減少 1.0%，主要由於智能卡芯片的需求減少，大部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度分立器件銷售收入 9,420 萬美元，同比增加 7.2%，主要得益於 IGBT 及通用 MOSFET 產品的需求增加，部分被超級結產品的需求減少所抵消。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 4,590 萬美元，同比增長 99.1%，大部分得益於 CIS 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,950 萬美元，同比增加 30.3%，主要得益於 LED 照明及其他 PMIC 產品的需求增加。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 290 萬美元，同比減少 12.3%，主要由於 EEPROM 產品的需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二零年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第四季度 % (未經審核)	二零一九年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	3,388	1.2 %	7,414	3.1 %	(4,026)	(54.3)%
90nm 及 95nm	43,430	15.5 %	14,914	6.1 %	28,516	191.2 %
0.11 μ m 及 0.13 μ m	63,303	22.6 %	64,900	26.7 %	(1,597)	(2.5)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	37,805	13.5 %	30,566	12.6 %	7,239	23.7 %
0.25 μ m	4,211	1.5 %	3,056	1.3 %	1,155	37.8 %
0.35 μ m 及以上	127,957	45.7 %	121,934	50.2 %	6,023	4.9 %
銷售收入總額	280,094	100.0 %	242,784	100.0 %	37,310	15.4 %

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 340 萬美元，同比減少 54.3%，主要由於邏輯產品的需求減少。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 4,340 萬美元，同比增長 191.2%，主要得益於 CIS 及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入銷售收入 6,330 萬美元，同比減少 2.5%，主要由於智能卡芯片及邏輯產品的需求減少，部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 3,780 萬美元，同比增長 23.7%，主要得益於邏輯、其他 PMIC、MCU 及模擬產品的需求增加。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 420 萬美元，同比增長 37.8%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.280 億美元，同比增長 4.9%，主要得益於 IGBT、LED 照明、通用 MOSFET 及其他 PMIC 產品的需求增加，部分被智能卡芯片及超級結產品的需求減少所抵消。

銷售收入分析

按終端市場分佈 劃分的銷售收入	二零二零年	二零二零年	二零一九年	二零一九年	同比	同比
	第四季度	第四季度	第四季度	第四季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
電子消費品	176,387	63.0 %	152,444	62.8 %	23,943	15.7 %
工業及汽車	47,401	16.9 %	62,971	25.9 %	(15,570)	(24.7)%
通訊	46,487	16.6 %	17,663	7.3 %	28,824	163.2 %
計算機	9,819	3.5 %	9,706	4.0 %	113	1.2 %
銷售收入總額	280,094	100.0 %	242,784	100.0 %	37,310	15.4 %

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.764 億美元，占銷售收入總額的 63.0%，同比增長 15.7%，主要得益於 MCU、通用 MOSFET 及 LED 照明產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 4,740 萬美元，同比減少 24.7%，主要由於 MCU、智能卡芯片及通用 MOSFET 產品的需求減少。
- 本季度通訊產品銷售收入 4,650 萬美元，同比增長 163.2%，主要得益於 CIS 產品的需求增加。
- 本季度計算機產品銷售收入 980 萬美元，同比基本持平。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零二零年	二零一九年	二零二零年
	第四季度	第四季度	第三季度
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
1 號晶圓廠 (200mm)	65	65	65
2 號晶圓廠 (200mm)	60	60	60
3 號晶圓廠 (200mm)	53	53	53
7 號晶圓廠 (300mm)	20	10	14
合計折合 8 吋產能	223	201	210
產能利用率 (200mm)	104.4%	92.5%	102.0%
產能利用率 (300mm)	75.5%	31.6%	56.4%
總體產能利用率	99.0%	88.0%	95.8%

- 本季度末月產能達 223,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 99.0%，環比上升 3.2 個百分點。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

折合 8 吋片晶圓	二零二零年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零二零年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	628	515	577	21.9 %	8.8 %

- 本季度付運晶圓 628,000 片，同比增加 21.9%，環比增加 8.8%。

經營開支分析

以千美元計	二零二零年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零二零年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,331	2,899	1,612	(19.6)%	44.6 %
管理費用 ⁷	58,803	68,462	72,588	(14.1)%	(19.0)%
經營開支	61,134	71,361	74,200	(14.3)%	(17.6)%

- 經營開支 6,110 萬美元，同比下降 14.3%，環比下降 17.6%，主要由於研發活動的政府補助增加，部分被折舊費用增加所抵消。

其他收入淨額

以千美元計	二零二零年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零二零年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,362	3,091	3,257	8.8 %	3.2 %
利息收入	2,604	2,898	2,433	(10.1)%	7.0 %
以公允價值計量且變動計入當期損益 的金融資產之公允價值變動收益	-	4,776	225	(100.0)%	(100.0)%
匯兌收益/(損失)	11,583	(2,185)	3,224	(630.1)%	259.3 %
分佔一家聯營公司溢利	12,803	6,401	5,998	100.0 %	113.5 %
財務費用	(1,771)	(324)	(579)	446.6 %	205.9 %
政府補貼	(4,597)	9,098	9,217	(150.5)%	(149.9)%
其他	509	390	281	30.5 %	81.1 %
其他收入淨額	24,493	24,145	24,056	1.4 %	1.8 %

- 其他收入淨額 2,450 萬美元，同比上升 1.4%，環比上升 1.8%，主要得益於匯兌收益和分佔一家聯營公司溢利增加，部分被政府補貼減少所抵消。

⁷管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零二零年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零二零年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得/(用)現金流量淨額	84,492	(7,269)	89,410	(1,262.4)%	(5.5) %
投資活動所(用)/得現金流量淨額	(223,167)	4,040	(315,355)	(5,623.9)%	(29.2)%
融資活動所得/(用)現金流量淨額	319,899	(1,642)	222,096	(19,582.3)%	44.0 %
外匯匯率變動影響淨額	25,103	6,487	21,351	287.0 %	17.6 %
現金及現金等價物變動影響淨額	206,327	1,616	17,502	12,667.8 %	1,078.9 %

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 8,450 萬美元，上年同期為所用現金流量淨額 730 萬美元，主要由於貿易應收項及應收票據的回收增強，及收到增值稅退稅款增加，部分被預付款的增加所抵消。
- 投資活動所用現金流量淨額 2.232 億美元，其中固定資產及無形資產投資支出 3.050 億美元，部分被(i)收到政府對設備的補助 8,010 萬美元，及(ii)利息收入 170 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 3.199 億美元，其中(i)提取銀行借 6.737 億美元，及(ii)發行股份收到 60 萬美元，部分被(i)償還銀行貸款本金 3.523 億美元，(ii)支付利息 160 萬美元，及(iii)租賃負債支出 50 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於十二月三十一日 二零二零年 (未經審核)	於九月三十日 二零二零年 (未經審核)
資產總額	4,568,586	4,022,672
負債總額	1,214,465	847,962
所有者權益總額	3,354,121	3,174,710
資產負債率 ⁸	26.6%	21.1%

資本開支

以千美元計	二零二零年 第四季度 (未經審核)	二零二零年 第三季度 (未經審核)
華虹 8 吋	32,858	52,407
華虹無錫	272,190	351,179
合計	305,048	403,586

- 本季度資本開支 3.050 億美元，其中 2.722 億美元用於華虹無錫。

⁸資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於十二月三十一日 二零二零年 (未經審核)	於九月三十日 二零二零年 (未經審核)
存貨	226,476	205,223
貿易應收款項及應收票據	120,952	122,938
預付款項、按金及其他應收款項	130,979	66,261
應收關聯方款項	4,706	11,292
已凍結存款及定期存款	359	345
現金及現金等價物	922,786	716,459
流動資產總額	1,406,258	1,122,518
貿易應付款項	130,980	96,232
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	386,305	386,672
計息銀行借款	47,784	223,844
租賃負債	4,235	3,513
政府補助	58,926	59,076
應付關聯方款項	12,647	12,790
應付所得稅	24,171	21,350
流動負債總額	665,048	803,477
淨營運資金	741,210	319,041
速動比率	1.8x	1.1x
流動比率	2.1x	1.4x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	40	47
存貨周轉天數	93	90

- 存貨由上季度末的 2.052 億美元上升至本季度末的 2.265 億美元，主要由於客戶需求增加。
- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 6,630 萬美元上升至本季度末的 1.310 億美元，主要由於預付款的增加。
- 應收關聯方款項由上季度末的 1,130 萬美元下降至本季度末的 470 萬美元，主要由於收回關聯客戶的貿易應收款。
- 貿易應付款項由上季度末的 9,620 萬美元上升至本季度末的 1.310 億美元，主要由於原物料採購增加。
- 計息銀行借款由上季度末的 2.238 億美元下降至本季度末的 4,780 萬美元，主要由於本季度償還銀行貸款本金。
- 本季度末淨營運資金 7.412 億美元，流動比率 2.1。
- 本季度末貿易應收款項及應收票據周轉天數由上季度的 47 天縮短至 40 天。
- 本季度末存貨周轉天數 93 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零二零年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於九月三十日 二零二零年 (未經審核)
銷售收入	280,094	242,784	252,981
銷售成本	(207,825)	(176,755)	(191,689)
毛利	72,269	66,029	61,292
其他收入及收益	13,266	20,090	18,641
投資物業的公平值收益	198	163	-
銷售及分銷費用	(2,331)	(2,899)	(1,612)
管理費用	(58,803)	(68,462)	(72,588)
其他費用	(3)	(2,185)	(4)
財務費用	(1,771)	(324)	(579)
分佔一家聯營公司溢利	12,803	6,401	5,998
稅前溢利	35,628	18,813	11,148
所得稅開支	(7,421)	(4,785)	(10,046)
期內溢利	28,207	14,028	1,102
以下各方應佔利潤：			
母公司擁有人	43,609	26,186	17,694
非控股權益	(15,402)	(12,158)	(16,592)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.034	0.020	0.014
攤薄	0.033	0.020	0.013
用於計算持有人應佔每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,295,965,426	1,287,054,838	1,294,890,812
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,319,737,426	1,296,177,838	1,317,522,812

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (已審核)
銷售收入	961,279	932,567
銷售成本	(726,486)	(650,107)
毛利	234,793	282,460
其他收入及收益	57,313	69,091
投資物業的公平值收益	198	163
銷售及分銷費用	(8,169)	(8,828)
管理費用	(261,139)	(169,796)
其他費用	(10)	(406)
財務費用	(2,968)	(1,242)
分佔一家聯營公司溢利	26,059	10,131
稅前溢利	46,077	181,573
所得稅開支	(12,762)	(26,588)
年內溢利	33,315	154,985
以下各方應佔利潤:		
母公司擁有人	99,443	162,237
非控股權益	(66,128)	(7,252)
持有人應佔每股盈利		
基本	0.077	0.126
攤薄	0.076	0.125
用於計算持有人應佔每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,293,227,187	1,285,586,255
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,310,613,187	1,295,539,255

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於十二月三十一日 二零二零年 (未經審核)	於九月三十日 二零二零年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一九年 (已審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	2,510,442	2,272,520	1,558,283
使用權資產	79,221	77,323	74,526
投資物業	180,476	172,727	168,615
無形資產	36,947	33,603	13,322
於聯營公司的投資	105,218	88,494	73,142
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	230,265	212,754	207,689
長期預付款項	10,768	33,445	6,740
應收關聯方款項	26	180	6,808
遞延稅項資產	8,965	9,108	7,567
非流動資產總額	3,162,328	2,900,154	2,116,692
流動資產			
存貨	226,476	205,223	142,087
貿易應收款項及應收票據	120,952	122,938	164,968
預付款項、按金及其他應收款項	130,979	66,261	113,453
應收關聯方款項	4,706	11,292	9,262
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	-	-	519,779
已凍結存款及定期存款	359	345	70,776
現金及現金等價物	922,786	716,459	476,286
流動資產總額	1,406,258	1,122,518	1,496,611
流動負債			
貿易應付款項	130,980	96,232	86,119
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	386,305	386,672	303,614
計息銀行借款	47,784	223,844	4,300
租賃負債	4,235	3,513	1,922
政府補助	58,926	59,076	40,641
應付關聯方款項	12,647	12,790	10,655
應付所得稅	24,171	21,350	28,088
流動負債總額	665,048	803,477	475,339
流動資產淨額	741,210	319,041	1,021,272
總資產減流動負債	3,903,538	3,219,195	3,137,964
非流動負債			
計息銀行借款	518,391	19,823	21,502
租賃負債	17,405	17,311	16,694
遞延稅項負債	13,621	7,351	17,176
非流動負債總額	549,417	44,485	55,372
淨資產	3,354,121	3,174,710	3,082,592
權益和負債權益			
股本	1,979,033	1,974,417	1,966,095
儲備	549,409	394,214	279,146
本公司擁有人應佔權益	2,528,442	2,368,631	2,245,241
非控股權益	825,679	806,079	837,351
權益總額	3,354,121	3,174,710	3,082,592

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零二零年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於九月三十日 二零二零年 (未經審核)
經營活動所得/(用)現金流量：			
稅前溢利	35,628	18,813	11,148
折舊及攤銷	56,368	39,754	56,791
應佔聯營公司溢利	(12,803)	(6,401)	(5,998)
營運資金的變動及其它	5,299	(59,435)	27,469
經營活動所得/(用)現金流量淨額	84,492	(7,269)	89,410
投資活動所/(用)得現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(305,048)	(129,206)	(403,586)
收到政府對物業、廠房及設備的補助	80,136	94,519	-
其他投資活動所得現金流量	1,745	38,727	88,231
投資活動所/(用)得現金流量淨額	(223,167)	4,040	(315,355)
融資活動所得/(用)現金流量：			
提取銀行貸款	673,747	-	219,439
發行股份所得收益	602	1,204	3,741
償還銀行貸款	(352,299)	(2,150)	-
償還租賃負債	(524)	(612)	(1,009)
已付利息	(1,627)	(84)	(75)
融資活動所得/(用)現金流量淨額	319,899	(1,642)	222,096
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	181,224	(4,871)	(3,849)
外匯匯率變動影響淨額	25,103	6,487	21,351
期初現金及現金等價物	716,459	474,670	698,957
期末現金及現金等價物	922,786	476,286	716,459

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (已審核)
經營活動所得現金流量：		
稅前溢利	46,077	181,573
折舊及攤銷	206,354	128,711
應佔聯營公司溢利	(26,059)	(10,131)
營運資金的變動及其它	42,738	(137,219)
經營活動所得現金流量淨額	269,110	162,934
投資活動所用現金流量：		
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(1,087,257)	(922,281)
收到政府對物業、廠房及設備的補助	80,136	94,519
其他投資活動所得現金流量	601,460	105,175
投資活動所用現金流量	(405,661)	(722,587)
融資活動所得現金流量：		
提取銀行貸款	893,186	-
非控股權益出資	-	317,000
發行股份所得收益	8,177	2,550
向股東支付股息	-	(50,963)
已凍結存款的增加	-	(22)
償還銀行貸款	(354,418)	(4,332)
償還租賃負債	(4,661)	(975)
已付利息	(1,857)	(360)
融資活動所得現金流量	540,427	262,898
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	403,876	(296,755)
外匯匯率變動影響淨額	42,624	(3,959)
年初現金及現金等價物	476,286	777,000
年末現金及現金等價物	922,786	476,286

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二一年二月九日